

**第六届“IC 的先进光子学失效分析技术”国际研讨会**  
**6<sup>th</sup> International Workshop on**  
**Advanced Photonics Failure Analysis Technology in IC**  
**APFA'07**

时间：2007年11月27日（星期二） 9:10 – 17:00

地点：上海邯郸路220号 复旦大学 逸夫科技楼 多功能厅（二楼）

主办：复旦大学国家微分析中心 日本HAMAMATSU光子学株式会社

*如果您设计/制造/使用的IC产品存在可靠性问题，  
此次研讨会将使您受益！*

随着集成电路不断向高集成度和深亚微米尺寸发展，对IC芯片设计和制造中器件的性能、可靠性和质量控制提出了更高的要求。本次研讨会以推进IC先进可靠性和失效分析技术的应用为目的，邀请了国内外专家进行该领域最新技术动态论述以及先进可靠性和失效分析技术的应用介绍。我们热忱欢迎从事IC芯片设计、制造、封装和应用领域的同仁们积极与会进行交流。

会议语言为中文/英语。

注册： **11月23日前**返回回执者注册费为150元/人，11月23日后为 200元/人，

注册费均现场交纳，同一单位4人（含）以上与会八折优惠。

APFA研讨会将提供论文集、工作午餐、会间茶和精美纪念品等。

## 报 告 目 录

- 1 KIIYOSH NIKAWA, NEC ELECTRONICS (JAPAN)  
“LSI Failure Analysis Overview: Today and Tomorrow” (Keynote)
- 2 MORRIS (MING-DOU) KER, CHIAO-TUNG UNIVERSITY (TAIWAN)  
“Introduction to On-Chip ESD Protection Design in CMOS Integrated Circuits” (Keynote)
- 3 XINGGONG WAN, HHNEC MT (SHANGHAI)

**“Wafer-Level-Reliability Characterization on Deep-submicron MOSFETs”  
(Keynote)**

- 4 TOSHIHIRO KUME, HAMAMATSU PHOTONICS (JAPAN)  
**"Digital lock-in technique applied to IR-OBIRCH and THEMOS"**
- 5 JIANLEI TAO, FUDAN UNIVERSITY  
**"Backside Observation Mode In Photon Emission Microscopy(PEM)"**
- 6 KERRY YANG, INTEL(SHANGHAI)  
**"Application of highly sensitive IR-OBIRCH for memory failure analysis"**
- 7 HUAPING LAI, HHNEC(SHANGHAI)  
**"EMMI and OBIRCH's application For Leakage Problem"**
- 8 DONG WANG, FREESCAL(TIANJIN)  
**"OBIRCH Applications in Failure Analysis of IC"**
- 9 PINGYUE FAN, FUDAN UNIVERSITY  
**"Silicon Dies Crack Issues and Its Mechanism"**